

课程名称: Design House Outsourcing 须知ABC

课程简介:

芯片设计完成后，还需要经过wafer制造，封装，测试等多道工序。本课程通讲述wafer sort,封装以及测试这3个方面的基础知识，流程和注意点，来使学员了解这3个重要环节的概况，过程和细节。为更好的做好芯片设计完成后的Outsourcing工作，提供指导和帮助。

课程对象:

将要或正在从事IC测试的工程师(DesignHouse,Fab,Testing)
工作业务和IC测试有关的，对IC测试有兴趣的工程师。

收费标准:

500 RMB/人 (含讲义及午餐；团体另有优惠)

课程安排

| 上课日期 | 上课时间 | 课程内容 | 讲师 |
|------|-------------|---|---------|
| 一天 | 9:00-9:30 | 开场白 | 资深测试工程师 |
| | 9:30-10:20 | wafer sort 流程 生产控制 wafer sort 阶段的测试 | |
| | 10:20-10:30 | 休息 | |
| | 10:30-11:50 | 封装概要 L/F封装流程 | |
| | 11:50-13:00 | 午餐和休息 | |
| | 13:00-14:00 | BGA封装流程 ESD | |
| | 14:30-14:10 | 休息 | |
| | 14:10-15:10 | 半导体结构 ATE作用 | |
| | 15:10-15:20 | 休息 | |
| | 15:20-17:20 | 如何做芯片测试 Technical Center参观及设备介绍 | |